



LOTPASTE SC 150

Typ ISO 1.2.3.C

Die Lotpaste SOLDER CHEMISTRY SC 150 ist die neueste, einzigartige Kreation, speziell für das Löten in der Dampfphase (vapor phase) und unter Schutzgas konzipiert. Ihrer Entwicklung liegen nicht nur langjährige Erfahrungen auf dem SMT-Gebiet und die dauerhafte Zusammenarbeit mit den Benutzern von Dampfphaseöfen, sondern auch die sorgfältige und strenge Beachtung der Richtlinien von DIN-, EN-, IPC-, und MIL-Normen zugrunde.

Die SC 150 ist physikalisch gesehen eine gleichmäßige Mischung aus einem Weichlotpulver, in allen erforderlichen Legierungen und Körnungen lieferbar, mit einem organischen Bindemittel auf **Kunststoffbasis**, das der RE L0 nach J-STD 005 entspricht und dadurch zu den allerneuesten extrarückstandsarmen "vapor phase"-Lotpasten gehört. Außer der hervorragenden Konturenstabilität, keiner Lotkugel- oder Spritzerbildung, einer langzeitigen Verarbeitbarkeit und langen Lagerzeit, sowie hoher Temperaturstabilität, zeichnen diese Paste folgende Vorteile aus:

- *SC 150* Wasserklarer, kaum sichtbarer Rückstand von nur 2,4 % !
- *SC 150* Kein Grabsteineffekt ("tombstoning")
- *SC 150* Enthält Korrosionsinhibitoren
- *SC 150* Eine hervorragende Druckqualität, stundenlang!
- *SC 150* Keine Verschmutzung der Lötanlagen mit teerartigen Rückständen
- *SC 150* Exzellente Lötergebnisse, auch bei 5% Restsauerstoff in N₂-Anlagen

PHYSIKALISCHE DATEN

Metallpulver: Standard-Legierungen 62Sn\2Ag, 63Sn\37Pb und absoluter **Grabsteineffekt-„Killer“ die L-62,5Sn/Pb/1Ag**. Bezeichnung der Korngröße:

nach SC	nach DIN 32 513	Durchmesser	mesh size
Fein (T3)	Kl. 3	25-45µm	325-500
Superfein (T4)	Kl. 4	20-35µm	450-700

VISKOSITÄT (Pa.s) +/-10% gemessen mit Brookfield RVT-DV Viskosimeter bei 91% Metallgehalt

Korngröße	Viskosität
Fein (T3)	700-800
Super-Fein (T4)	750-850

OBERFLÄCHENWIDERSTAND (SIR) und elektrolytische Korrosionswirkung nach DIN 32513

Messungen am	4.Tag	21.Tag
	$2,8 \times 10^{13}$	$3,5 \times 10^{13}$

QUALIFIKATIONEN

Die Lotpaste SC 150 ist sowohl eine Vapor Phase Lotpaste, als auch eine N₂- Paste, die den Anforderungen der führenden Häuser auf dem Gebiet des Dampfphase- und Stickstofflötens entspricht. Der Korrosions-, Lotkugel- und der Benetzungstest sowie die Konturenstabilitätsprüfung wurden bestanden. Laboruntersuchungen bestätigen korrosionsfreie, der RE L0 (no-clean) entsprechende, Rückstände, die auf der Leiterplatte bedenkenlos verbleiben können, auch unter dem Schutzlack.

VERBRAUCHERHINWEISE

Nach Entnahme der Paste, das Gebinde möglichst fest verschließen. Die benutzte Paste soll nicht mit der frischen zusammen aufbewahrt werden. Im laufenden Arbeitsprozess darf selbstverständlich neue Paste der älteren als Auffrischung zugeführt werden. Verschiedene Lotlegierungen und Pastentypen sollte man nicht vermischen.

Empfohlene Rakelgeschwindigkeit: 15-100 mm/s.

Merke(!) Der Pastendrucker ist immer schneller als der schnellste Bestücker in Ihrer Linie. Das Wichtigste ist, daß die Paste beim Drucken am Rakel abrollt.

Für Schablonendruck wird eine Paste mit 91% Metallgehalt empfohlen

Die Reinigung der Schablone kann mit einer Alkoholmischung erfolgen, aber das Reinigungsmedium darf unter keinen Umständen mit der Paste in Verbindung kommen.

Für diesen Vorgang empfehlen wir deswegen den **SC Schablonenreiniger!**

LAGERUNG

Ungeöffnetes Gebinde bei ca. 20°C (RT) : 6 Monate. **Eine Lagerung im Kühlschrank ist nicht notwendig!**

Im geöffneten Zustand bzw. am Rakel der Druckeinrichtung ist die max. Verarbeitungszeit, wie auch immer, abhängig von den Umwelteinflüssen denen die Paste ausgesetzt wird.

So bestellen Sie Ihre Solder Chemistry Paste

Legende	Pastentyp	Korngröße	Legierung	Fluxgehalt	Gebindegröße
z.B.	SC 150	T3	62/36/2Ag	09%	500g
	SC 150	T4	62,5/1Ag	10%	200g

Bestellbeispiel nach DIN:

Lotpaste(SC...) L-Sn62Pb2Ag / F-SW 32 / 90-3 200g(Gebinde)

Solder Chemistry ; Fragnerstraße 4 ; D-84034 Landshut
Tel. ++49/871/4309500 ; Fax. ++49/871/43095020
e-Mail: info@SolderChemistry.com ; www.solderchemistry.com

Vorstehende Angaben sollen sie bestmöglich informieren. Eine Verbindlichkeit kann jedoch aufgrund der Vielseitigkeit der Materialien, Anwendungen und Arbeitsprozesse, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte und Verpflichtungen Dritter, nicht übernommen werden.